

Ministerpräsidentin und Wissenschaftsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie betonte, dass das Land keine zusätzlichen Mittel für die Hochschulen geben könne, und erntete dafür lautstarken Protest. „Wer etwas anderes fordert, soll sagen, wo das Geld dafür herkommen soll“, entgegnete sie. Kramp-Karrenbauer stellte aber Geld aus dem Hochschulpakt und aus den freiwerdenden BAföG-Mitteln des Landes von rund sechs Millionen Euro pro Jahr in Aussicht.

Uni-Präsident Volker Linneweber begrüßte in seiner Rede, dass das Saarland seine freiwerdenden BAföG-Mittel komplett in den Bildungsbereich investieren wolle.



O. Dietze

Blick auf den Saarbrücker Campus der Universität des Saarlandes

Gleichzeitig forderte er aber eine „feste Zusage“, dass diese Mittel auch bis zum Jahr 2020 fließen. Die Landesregierung müsse endlich für Planungssicherheit sorgen, forderte Linneweber. „Wenn es bei den Kürzungen bleibt, werden diese ab

2017 zerstörerisch in die Strukturen der Universität eingreifen“, erwartet Birringer, „wir werden allerdings nicht kampflos aufgeben und uns unsere Uni kaputt sparen lassen.“

Alexander Pawlak

■ Schub für Europas Elektronik

Europa und die EU-Mitgliedsstaaten fördern Forschungsprojekte zur Mikroelektronik.

Der weltweite Markt für Halbleiter-Bauelemente ist auch im vergangenen Jahr wieder gewachsen – nach vorläufigen Zahlen der Analysten von Gartner um 7,9 Prozent auf knapp 340 Milliarden US-Dollar. Während dieses Geschäft fest in den Händen von Intel, Samsung, Qualcomm und weiteren Giganten der Branche aus USA, Korea und Japan ist, hatte das größte europäische Unternehmen, STMicroelectronics mit Sitz in Amsterdam, im vergangenen Jahr einen Weltmarktanteil von bescheidenen 2,2 Prozent. Mit dem Ziel, den Anteil der europäischen Mikroelektronik erheblich zu steigern, hat die Europäische Union die Initiative „Electronic Components and Systems for European Leadership“ (ECSEL) ins Leben gerufen. Ziel ist es, „risikoreiche industrielle Forschungs- und experimentelle vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben“ zu fördern. Mitte Dezember sind die Förderentscheidungen der ersten Ausschreibungen gefallen.

ECSEL ist in das Rahmenprogramm Horizon2020 eingebettet und in die Themen „Mikro- und Nanoelektronik“, „Embedded / Cyber-Physical Systems“ sowie

„Smart Systems Integration“ untergliedert. Insgesamt stellen die EU sowie die Mitgliedsstaaten dafür bis 2024 jeweils 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung, von der Industrie werden weitere 2,4 Milliarden erwartet. Die Förderquoten hängen davon ab, ob ein Projekt stärker risikobehaftet oder näher an der Umsetzung ist, und variieren auch stark je nach Land und Projektpartner. An jedem Projekt müssen Institutionen aus mindestens drei Ländern beteiligt sein.

Von 48 eingereichten Anträgen sind nur neun an der Begutachtung gescheitert. Aufgrund begrenzter öffentlicher Mittel wurden jedoch nur zwölf bewilligt; zehn davon mit der Beteiligung deutscher Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Zu den bewilligten Projekten gehört „ADMONT“ unter der Führung des Dresdner Chip-Herstellers X-Fab, in dem es um Halbleiterchips jenseits von CMOS geht. Diese „More than Moore Technologies“ sollen neue Funktionalitäten ermöglichen für die Bereiche Energie, Gesundheit, Mobilität und Industrieproduktion. Unter Führung von Infineon Technologies ist das Ziel von „Power-



STMicroelectronics

Base“ die Weiterentwicklung von Chips auf der Grundlage von Galliumnitrid (GaN) für die Leistungselektronik. Im Mittelpunkt weiterer Projekte stehen Substrate aus Siliziumkarbid für sehr schnelle Chips aus GaN oder Fahrerassistenzsysteme für Autos.

Die zwölf Projekte haben ein Gesamtvolumen von 710 Millionen Euro, rund 300 Millionen davon sind öffentliches Geld. Die deutschen Projektpartner erhalten 32 Millionen vom BMBF, weitere 7 Millionen steuert Sachsen bei, das damit die Unternehmen in „Silicon Saxony“ fördert. Auf die deutschen Industriepartner entfallen rund 100 Millionen Euro.

Stefan Jorda

STMicroelectronics ist das einzige europäische Elektronik-Unternehmen unter den Top 10.